

平成 16 年 1 月 30 日

各 位

会社名 京セラ株式会社
代表者名 取締役社長 西口 泰夫
(コード番号 6971 東証・大証第1部)
問合せ先 執行役員常務 財務統括部長
石田 秀樹
(TEL. 075-604-3500)

京セラグループの有機材料部品事業の統合に関するお知らせ

平成 15 年 12 月 19 日にお知らせしました標記の件について、本日開催した当社取締役会において分割契約書が承認されましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

昨年8月、京セラは日本IBM社から同社野洲事業所のSLC事業を引き継ぎ有機材料部品事業(チップ・キャリアの事業 および、ボードの事業)を強化するため、京セラSLCテクノロジー株式会社を全額出資子会社として設立し、9月1日より事業運営を開始致しました。以来、市場動向を踏まえながらグループ内の有機材料部品事業の在り方について検討して参りましたが、大幅な事業の拡大を図るためには、有機材料部品事業に関する経営リソースを京セラSLCテクノロジーに集約し、シナジー効果をより一層高めるとともに、同社の専門メーカーとしての事業基盤を拡充することが重要であると判断致しました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割契約書承認取締役会	平成 16 年 1 月 30 日
分割契約書調印	平成 16 年 1 月 30 日
分割契約書承認総会	京セラ、及び京セラSLCテクノロジーは、それぞれ商法第374条ノ22、第374条ノ23(簡易分割手続)の規定により株主総会の承認を得ずに分割致します。
分割期日	平成 16 年 4 月 1 日(予定)
分割登記	平成 16 年 4 月 1 日(予定)

(2) 分割方式

分割方式

京セラを分割会社とし、既存の京セラの全額出資子会社である京セラS L Cテクノロジーを承継会社とする分社型吸収分割とします。

当該分割方式を採用した理由

京セラの全額出資子会社である京セラS L Cテクノロジーに京セラの有機材料部品事業を統合するためには、分割に際して発行する株式を京セラに割り当てる分社型吸収分割が最適であると判断しました。

(3) 株式の割り当て

株式割り当て比率

京セラS L Cテクノロジーが本分割に際して発行する株式1株を京セラに割り当て交付します。

株式割当比率の算定根拠

京セラS L Cテクノロジーは京セラの全額出資子会社であり、また、本分割に際し発行する株式数を京セラに割り当てる分社型吸収分割であるため、承継する資産、負債は帳簿価額にて承継することとなります。本分割により、承継する資産と負債の差額が京セラの子会社株式として増加するため、割り当てる株式数の如何にかかわらず京セラの純資産に変動はありません。従って、双方の合意により割り当てる株式数を1株と決定致しました。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 承継会社(京セラS L Cテクノロジー)が承継する権利義務

分割期日において、京セラの有機材料部品事業部に属する資産及び負債、及び契約上の地位に基づく権利義務を承継します。

(6) 債務履行の見込み

分割会社(京セラ)

京セラの資産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務の履行の確実性には問題がないものと判断します。

承継会社(京セラS L Cテクノロジー)

京セラS L Cテクノロジーの資産、負債及び純資産の額、承継する資産、負債及び純資産の額等を勘案して、負担すべき債務の履行の確実性に問題がないものと判断します。

- (7) 承継会社(京セラ S L Cテクノロジー)に新たに就任する役員
 本公司分割に際して京セラ S L Cテクノロジーに新たに就任する役員はいません。

3. 分割する事業部門の内容

- (1) 有機材料部品事業部の内容
 有機材料部品(チップ・キャリア、マザーボード等)の設計、開発、製造
- (2) 有機材料部品事業部 (京セラ)の平成 15 年 3 月期における経営成績
 京セラの有機材料部品事業部の平成 15 年 3 月期の売上高は約 3,040 百万円となっており、京セラの同期売上高 482,834 百万円の 0.63%に相当致します。

- (3) 譲渡資産、負債の項目及び金額(平成 15 年 9 月 30 日現在) (単位:百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	2,923	流動負債	414
固定資産	2,545	固定負債	0
その他投資等	0		
合計	5,468	合計	414

* 平成 15 年 9 月 30 日現在における承継する資産額(5,468 百万円)は、同日現在の京セラの総資産額(1,251,420 百万円)の 0.44%に相当致します。

4. 分割後の京セラの状況

- (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期、いずれも分割による変更はありません。
- (2) 総資産
 京セラ S L Cテクノロジーに承継する負債の金額だけ減少することとなります。
- (3) 業績に与える影響
 分割期日は平成 16 年 4 月 1 日を予定しているため、本件が平成 16 年 3 月期業績予想に及ぼす影響はありません。

5. 分割当事会社の概要(平成15年9月30日現在)

(1) 商号	京セラ株式会社	京セラSLCテクノロジー株式会社
(2) 事業内容	ファインセラミック関連事業 電子デバイス関連事業 機器関連事業 その他の事業	特殊プラスチックの製造・販売、研究 複合材料の製造、販売、研究
(3) 設立年月日	昭和34年4月	平成15年8月
(4) 本店所在地	京都市伏見区	滋賀県野洲郡野洲町
(5) 代表者	取締役社長 西口 泰夫	取締役社長 前 耕司
(6) 資本金	115,703 百万円	4,000 百万円
(7) 発行済株式総数	191,309,290 株 (内、自己株式 3,822,655 株)	160,000 株
(8) 株主資本	980,458 百万円	7,697 百万円
(9) 総資産	1,251,420 百万円	8,569 百万円
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 従業員数	13,678 名	278 名
(12) 主要取引先	<仕入先> 松下電器産業(株)、三井物産(株)、 ソニー(株) <販売先> 富士通(株)、(株)日立製作所、 日本電気(株)	<仕入先> 日立化成(株)、味の素(株)、 <販売先> IBM、新光電気(株)、ソニー(株)
(13) 大株主及び 持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口) 8.61% ・日本マスタートラスト 信託銀行(株)(信託口) 4.57% ・(株)京都銀行 3.77% ・稲盛和夫 3.56% ・UFJ信託銀行(株) (信託A口) 2.95% 	<ul style="list-style-type: none"> ・京セラ(株) 100.00%
(14) 主要取引銀行	(株)京都銀行 (株)UFJ銀行	(株)東京三菱銀行 (株)滋賀銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	京セラSLCテクノロジー(株)は、京セラ(株)の100%子会社です。
	人的関係	京セラ(株)は、京セラSLCテクノロジー(株)に取締役、監査役を派遣し、また、従業員を出向させています。
	取引関係	有機材料部品の製造、販売、開発等

(16) 最近3決算期の業績

(単位:百万円)

決算期	京セラ株式会社 (親会社)			京セラSLCテクノロジー株式会社 (全額出資子会社)		
	平成13年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期	平成13年 3月期	平成14年 3月期	平成15年 3月期
売上高	652,510	499,264	482,834	-	-	-
経常損益	114,500	56,412	54,685	-	-	-
当期純損益	31,398	34,475	27,923	-	-	-
1株当たり 当期純損益	164.98円	182.36円	149.45円	-	-	-
1株当たり 配当金	60.00円	60.00円	60.00円	-	-	-
1株当たり 株主資本	4,675.06円	4,652.07円	4,676.97円	-	-	-

*京セラSLCテクノロジー(株)の事業運営開始日は平成15年9月1日であり、平成15年3月期までの実績はありません。

以上